

Bild 1
Härteverlauf einer AlCu-Legierung beim Walzen um 10% und Auslagern bei 150°C nach verschiedener Vorbehandlung nach G. Wassermann (5)

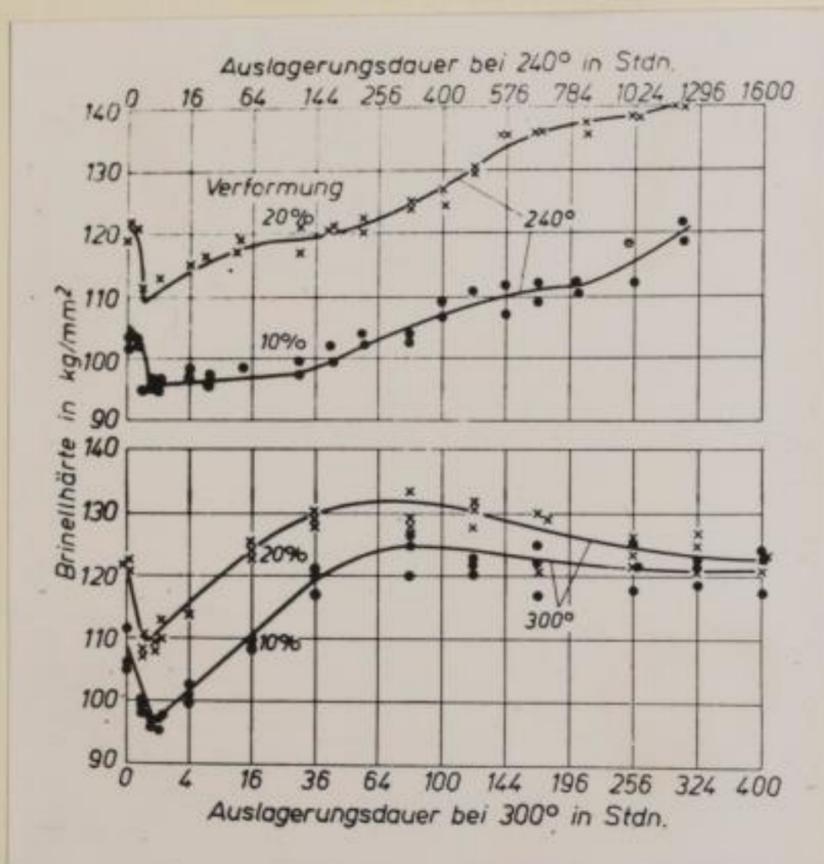


Bild 2
Härteverlauf einer Cu-Legierung mit 4,3% Cd nach Homogenisierung bei 650°C und Abschrecken an Luft beim Walzen um 10% und 20% und Auslagern bei 240°C und 300°C nach G. Schlösser und G. Wassermann (7)